

# 上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)  
海通证券股份有限公司

股票简称:沪硅产业 股票代码:688126

## 特别提示

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“沪硅产业”、“硅产业集团”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2020年4月20日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

## 第一节 重要声明与提示

一、重要声明  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司招股说明书全文,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无不特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示  
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险,理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险  
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板新股上市首日涨跌幅限制比例为44%、涨跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市前的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险  
上市初期,原始股东的股份锁定期为36个月至12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高管与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者锁定12个月,网下限售股份锁定期为6个月。本公司发行后总股本为2,480,260,000股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为449,819,899股,占本次发行后总股本的比例为18.14%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险  
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会增加标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示  
(一)公司尚未盈利且母公司存在累计未弥补亏损风险  
2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,公司的营业收入分别为27,006.50万元、69,379.59万元、101,044.55万元和107,026.38万元,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-9,081.32万元、-9,941.45万元、-10,333.31万元和-15,717.80万元,均为负值。

截至2019年9月末,公司经审计的母公司报表未分配利润为-12,352.38万元,合并报表中未分配利润为21,795.94万元,母公司报表可供股东分配的利润为负值。若公司不能尽快实现盈利,或者控股子公司缺乏现金分红的能力,公司在短期内无法完全弥补累积亏损。在首次公开发行股票并在科创板上市后,公司将存在短期内无法向股东现金分红的风险,将对股东的投资收益造成不利影响。

(二)行业景气度下降及经营业绩下滑风险  
发行人2019年1-9月营业收入为107,026.38万元,较上年同期(未经审计)增加35,364.96万元,变动幅度为49.35%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期(未经审计)下降7,390.61万元,变动幅度为-269.75%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期(未经审计)下降8,845.83万元,变动幅度为-128.72%。

公司经营业绩下降主要是300mm半导体硅片业务带来亏损增加所致,由于2019年上半年受全球宏观经济低速影响,半导体行业表现疲软,半导体硅片市场也出现了阶段性调整。公司子公司上海新昇作为300mm半导体硅片的行业新进入者,系2018年下半年才进入规模化生产,因此在行业景气度较低时期,产品销售受到的影响也相应较大,产品平均销售单价较2018年下降16.84%;另一方面,2019年1-9月公司300mm半导体硅片产能利用率为44.36%,较2018年大幅下降,同时上海新昇的生产线机器设备大量转固产生的折旧费用大幅增加,使得产品平均单位成本较2018年增加21.61%,因此公司300mm半导体硅片出现较大亏损,产品毛利较上年同期下降,714.83万元。

尽管公司子公司2019年1-9月Okmetec的收入和净利润均较上年同期有所增加,2019年3月末纳入合并报表的新微科技的经营情况在2019年4-9月保持稳定,但如果后续宏观经济环境持续恶化或半导体行业景气度进一步下降,而上海新昇未能进一步扩大300mm半导体产品销售、提高产能利用率并有效降低成本,则公司存在未来业绩下滑幅度继续扩大的风险。同时,如果公司未来仍未盈利且业绩下滑幅度继续扩大,则公司的资金状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入等方面可能会面临受到限制或影响的风险。

(三)技术研发风险  
半导体硅片是芯片制造最重要的材料,是半导体产业的基石,同时半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。公司是我国率先实现300mm半导体硅片规模化生产的企业,300mm半导体硅片相关的技术达到了国际领先水平,但与国际前五大片硅制造企业产品在认证数量、适用的技术节点等方面相比仍有一定差距。当前公司正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中。

半导体硅片行业属于技术密集型行业,具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。随着全球芯片制造技术的不断演进,对半导体硅片的技术标准要求也在不断提高,若公司不能继续保持充足的研发投入,或者在关键技术上未能持续创新,亦或新产品技术指标无法达到预期,将导致公司与国际先进企业的差距再次扩大,对公司的经营业绩造成不利影响。

(四)关键技术人才流失风险  
我国半导体硅片产业起步较晚,国内关键技术人才非常稀缺,具有丰富经验的国际化技术团队是公司取得竞争优势的关键。截至2019年9月30日,公司已拥有技术研发人员423人,形成了以李伟博士、WANG QINGYU博士、Ate Haapilma博士为核心的国际化技术研发团队。公司已向技术团队提供了富有竞争力的薪酬待遇和股权激励,以提高技术团队的忠诚度和稳定性,但随着我国半导体硅片行业的持续发展,人才竞争将不断加剧,若公司的关键技术人才大量流失,将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

(五)市场竞争加剧风险  
全球半导体硅片行业市场集中度很高,主要被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的近90%企业占据。目前,全球前五大半导体硅片企业规模较大,合计市场份额达93%。其中,日本信越化学市场份额27.58%,日本SUMCO市场份额24.33%,德国Siltronic市场份额14.2%,中国台湾环球晶圆市场份额16.28%,韩国SK Siltronic市场份额占比为10.16%。相较于行业前五大半导体硅片企业,硅产业集团规模较小,占全球半导体硅片市场份额仅2.18%。

近年来随着我国对半导体行业的高度重视,在产业政策和地方政府的推动下,我国半导体硅片行业的新建项目也不断涌现,伴随着全球芯片制造产能向中国大陆转移的长期过程,中国大陆市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场,公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。因此,公司面临市场竞争加剧的风险,以及被替代的风险。

(六)客户认证风险  
芯片制造是芯片制造的核心材料,芯片制造企业对于半导体硅片的品质有着极高的要求,对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例,芯片制造企业需先对半导体硅片产品进行认证,才会将该硅片制造企业纳入供应链,一旦认证通过,芯片制造企业不会轻易更换供应商。公司作为中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业,300mm半导体硅片部分产品已获得格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、华润微电子等芯片制造企业的认证通过。截至2019年9月30日,公司300mm半导体硅片认证通过的客户数量已达49家,但300mm半导体硅片国产化时间较短,部分目标客户仍处于产品认证阶段,若公司的300mm半导体硅片产品未能及时获得重要目标客户的认证,将对公司的经营造成不利影响。

(七)无实际控制人风险  
公司无控股股东和实际控制人。截至本上市公告书签署日,国盛集团和产投投资基金为公司并列第一大股东,持股比例均为30.48%,充分制衡的股权结构虽然有利于提高决策的科学性,但也可能影响公司的决策效率,在公司需要迅速做出重大经营和投资决策时,充分制衡的股权结构可能导致公司错失发展机遇。

此外,国盛集团或产投投资基金虽然在发行人股票上市之日起12个月内不主动谋求对发行人的控制权,且承诺自发行人股票上市之日起36个月,但不排除在发行人股票上市12个月后,通过二级市场增持、协议受让、认购发行人增发的股份等方式,提高持有发行人股票比例,从而导致发行人本次发行前并列第一大股东的持股比例发生变化,并可能导致公司董事会成员构成发生变化,公司治理结构的变化可能对公司经营和业绩的稳定性产生不利影响。

(八)子公司整合及管理风险  
公司为控股型企业,公司报告期内通过业务重组控制了上海新昇、

Okmetec、新微科技三家子公司后,分别从资产、业务、团队建设等方面对上述子公司实施了整合,对控股子公司的研发、生产、经营、人事、财务等方面实施控制和管理。但是上海新昇报告期内尚未实现盈利,新微科技纳入公司合并报表时间较短,而Okmetec位于境外,子公司管理难度较大。若公司对控股子公司的控制体系得不到有效的执行,公司可能无法及时了解关于公司的实际经营情况,也无法实施有效的整合及管理措施,从而产生一定的子公司整合及管理风险。

(九)固定资产投资风险  
公司所处的半导体硅片行业属于典型的资本密集型行业,固定资产投资的需求较高,尤其是半导体硅片生产制造所需的机加工设备、抛光机、外延设备、检测设备、关键设备的购置成本高昂,规模化生产所需的生产线建设投入巨大。截至2019年9月30日,公司固定资产账面价值为297,365.04万元,占公司总资产比例为32.89%,其中机器设备账面价值为230,530.36万元。半导体硅片的生产线建设从设备调试、产品认证到批量生产,需要不断对制造工艺和技术参数进行调试。因此,半导体硅片的生产线从投产至达到设计产能,需要经历较长的周期。若公司营收规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧,公司将面临业绩下降的风险。

(十)商誉减值风险  
截至2019年9月末,公司商誉账面价值为110,784.03万元,其中因收购上海新昇、Okmetec和新微科技产生的商誉分别为4,530.45万元、68,075.64万元和38,177.93万元。公司已根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定对上海新昇、Okmetec和新微科技产生的商誉分别进行了减值测试,经测试,上述商誉均未发生减值。

半导体行业长期处于增长态势,但短期需求呈现一定的波动性的特征,2019年半导体行业疲软系行业周期性的波动,并未发生趋势性的下降。2019年1-9月公司各子公司的经营状况正常,其中Okmetec的收入和净利润均同比增长,但是上海新昇300mm半导体硅片业务的亏损较上年同期有所增加,如果后续宏观经济环境持续恶化或半导体行业出现趋势性下降,亦或上海新昇未能进一步扩大300mm半导体产品销售、提高产能利用率并有效降低成本,则公司存在商誉发生减值的风险。

(十一)知识产权争端风险  
公司所处的半导体硅片行业属于典型的技术密集型行业,具有技术优势的半导体硅片企业均会通过申请专利的方式对自身核心技术进行保护。截至2019年9月30日,公司及控股子公司拥有已获授权的专利340项,其中中国大陆117项,中国台湾地区及国外223项;公司拥有已获授权的发明专利312项。公司一方面重视自身研发体系的自主性与合规性,尽量避免自身技术和产品落入竞争对手专利的保护范围;另一方面公司也重视对自主知识产权的保护,建立了知识产权保护体系。若公司被竞争对手诉诸知识产权争端,或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯,将对公司的生产经营造成不利影响。

(十二)境外收入占比较高的风险  
公司子公司Okmetec的生产基地位于欧洲,来自欧洲及北美客户的营业收入占比较高。报告期内,上海新昇300mm半导体生产线经历从建设、试生产到达产的各个阶段,营业收入持续增长但绝对金额较小,而新微科技于2019年3月末前尚未纳入合并范围,报告期内Okmetec的营业收入在公司占比较高,同时上海新昇及新微科技亦有部分营业收入来自于境外。2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,公司的境外营业收入占比分别为90.91%、88.77%、80.88%及72.74%,虽然呈逐年下降趋势,但比重较大。如果出现国际贸易环境继续恶化、关税壁垒继续增加、汇率出现大幅度波动等不利情形,将影响公司的境外收入,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(十三)300mm半导体硅片产能利用率、产销量下滑趋势延续的风险  
2019年全球半导体行业景气度下降,公司300mm半导体硅片的销量增长不及预期,但产能仍处于稳定爬坡阶段,因此2019年1-9月公司300mm半导体硅片的产能利用率亦受到影响,下降至44.36%。由于公司及及时根据市场情况调整生产计划,公司300mm半导体硅片2019年1-9月的产销量仍保持在94.05%。公司作为300mm半导体硅片领域的新进入者,在行业景气周期将分享行业红利,产能利用率和产销量较高,而在行业景气度低的周期,受到的影响也相应较大。公司受宏观经济和行业自身因素影响,可能存在产能利用率、产销量短期内下滑趋势延续的风险。

(十四)经营业绩对政府补助存在一定依赖的风险  
由于公司所处的半导体硅片行业系国家重点鼓励、扶持的战略型行业,公司获得的政府补助金额较大。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月,公司计入其他收益/营业外收入的政府补助金额分别为1,782.35万元、9,729.74万元、16,605.95万元和10,685.12万元,占公司当期利润总额的比例分别为-19.66%、43.12%、47.11%和-365.44%,占比较高,对公司经营业绩的影响较大。若公司未来获得政府补助的金额下降,将对公司的固定资产投资及在建项目的资金保障造成一定的不利影响。公司经营业绩对政府补助存在一定依赖的风险。

(十五)发行人股票期权激励计划影响发行人盈利能力的风险  
发行人2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,该股票期权激励计划在发行人完成本次发行并在科创板上市后,将因股份支付会计准则,增加发行人未来的主营业务成本和期间费用。

基于截至2019年9月30日已授予且有效的期权份额,假设在未来年度都实现个人及公司的业绩考核要求,不考虑未来离职率影响的前提下,上述激励计划对发行人未来报告期间的成本、期间费用、利润总额和资本公积的具体影响如下:

单位:万元

科目	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合计
主营业务成本	167.14	250.72	186.34	103.63	26.12	733.96
期间费用	2,233.99	3,350.99	2,490.59	1,285.14	340.17	9,800.80
利润总额	-2,401.14	-3,601.71	-2,676.93	-1,488.78	-375.30	-10,543.85
资本公积	2,401.14	3,601.71	2,676.93	1,488.78	375.30	10,543.85

注:上述期权费用对未来报告期间的利润影响未考虑所得税的影响。

若发行人实施期权激励计划的效果不及预期,未来报告期间的营业收入及利润的增长无法覆盖期权激励计划造成的主营业务成本和期间费用的增加,则将对公司未来的盈利能力造成不利影响。

(十六)存货滞销和跌价风险  
2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末,公司存货账面价值分别为10,260.57万元、9,707.06万元、18,044.82万元和39,390.94万元,占资产总额的比例分别为2.34%、1.66%、2.64%和4.36%。公司存货绝对金额较大主要是因为公司原材料采购周期较长,需要预留足够的原材料用于生产。

报告期各期末,公司的存货跌价准备金额分别为0.0、159.58万元和1,281.29万元,占存货账面价值的形成原因为300mm硅片中的外延硅片生产尚在产能爬坡和产品持续认证阶段,工艺及品质尚待完善,生产成本高于其市价,导致产生了存货跌价准备。此外,2018年末,当时发行人的参股子公司新微科技(后于2019年3月末纳入合并财务报表范围)因有部分存货存在滞销的情况,出于谨慎性原则,新微科技对存货进行全面清查后,按存货成本高于其可变现净值的差额计提了3,786.51万元的存货跌价准备。

若未来半导体硅片市场景气度进一步下降,市场价格下跌,公司可能会面临存货滞销和存货跌价的风险。

(十七)2020年全球新型冠状病毒疫情对半导体行业造成不利影响的风险  
2020年初新型冠状病毒疫情爆发,公司及境内子公司春节后复工有所延迟,同时因交通运输受阻公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响。目前公司及境内子公司均已按照当地政府政策通知及指导要求在防控疫情的前提下全面复工,生产经营已恢复正常,公司境外子公司的生产经营暂未受到疫情影响,截至本上市公告书签署日,本次新型冠状病毒疫情尚未对公司的生产经营造成显著的直接风险。

但若本次疫情在我国长期无法得到有效控制,或者在欧洲、北美、日本、韩国等国家和地区爆发并难以有效控制,将可能对全球半导体产业链造成严重影响,可能导致公司下游芯片制造企业产量下滑,公司原材料供应短缺,公司境外子公司的生产经营受到影响等不利情形,将对公司的经营成果产生直接或间接的不利影响。

## 第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况  
(一)中国证监会同意注册的决定及主要内容  
公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的申请于2020年3月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1430号《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。

具体内容如下:  
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。  
二、你公司本次公开发行股票严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。  
三、本批复自同意注册之日起2个月内有效。  
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证交所同意股票上市的决定及其主要内容  
本公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准(自律监管决定书[2020]099号文)。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称为“沪硅产业”,证券代码为“688126”,其中44,981,989股股票将于2020年4月20日起上市交易。

二、股票上市相关信息  
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2020年4月20日  
(三)股票简称:沪硅产业  
(四)扩位简称:上海硅产业集团  
(五)股票代码:688126  
(六)本次公开发行后的总股本:2,480,260,000股  
(七)本次公开发行的股票数量:620,068,200股。本次发行均为新股,原股东不公开发售股份。

(八)本次上市的可流通限制及限售安排的股票数量:449,819,899股  
(九)本次上市的可流通限制或限售安排的股票数量:2,030,440,101股  
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:142,445,233股  
(十一)发行前股东所持股份的流通限制及限售:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十三)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证劵投资有限公司所持18,602,046股股份限售24个月,高管与核心员工专项资产管理计划所持8,226,221股股份限售12个月,其他战略投资者上海华虹(集团)有限公司所持12,789,203股股份及中国保险投资基金(有限合伙)所持102,827,763股股份限售12个月。(2)网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配客户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,本次发行承诺限售6个月的投资者所持股份为27,803,068股。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
(十五)上市保荐机构:海通证券股份有限公司

三、上市标准  
公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件:

1、发行后股本总额为人民币2,480,260,000.00元,不低于人民币3000万元;  
2、本次公开发行股份总数为620,068,200股,占发行后股份总数的25.00%;  
3、市值及财务指标  
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(四)条:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

发行人本次发行价格为3.89元/股,发行后股本总额为2,480,260,000.00元,由此计算对应发行后市值为人民币96.48亿元,2018年营业收入为人民币10.10亿元,满足上述上市标准。

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

## 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司概况

发行方名称	上海硅产业集团股份有限公司
英文名称	National Silicon Industry Group Co., Ltd.
注册资本	186,019.18万元(发行前)
法定代表人	俞跃辉
成立日期	2015年12月9日
整体变更设立日期	2019年3月11日
住所	上海市嘉定区外冈镇755号3幢
邮政编码	200050
电话	021-52589038
传真	021-52589196
互联网网址	www.nsig.com
电子信箱	PR@n-sig.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书	李伟
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务	公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售;研究、开发、生产、加工高端硅基集成电路材料、相关技术及相关产品,销售自产产品及提供相关的技术咨询和服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营范围	计算机、通信和其他电子设备制造业

二、控股股东、实际控制人的基本情况  
发行人不存在控股股东、实际控制人情况。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术员工基本情况及持股情况  
1、董事  
公司董事会成员基本情况如下:

姓名	现任职务	提名入	任期
俞跃辉	董事长	新微集团	2019.4.21-2022.3.10
戴敏波	副董事长	国盛集团	2019.3.11-2022.3.10
任凯	副董事长	产业投资基金	2019.3.11-2022.3.10
孙健	副董事长	国盛集团	2019.3.11-2022.3.10
杨胜凯	副董事长	产业投资基金	2019.3.11-2022.3.10
张伟	独立董事	董事会	2019.3.11-2022.3.10
张卫	独立董事	董事会	2019.3.11-2022.3.10
Li Ting Wei	独立董事	董事会	2019.6.11-2022.3.10

2、监事  
公司监事会成员基本情况如下:

姓名	现任职务	提名入	任期
杨路	监事会主席	国盛集团	2019.3.11-2022.3.10
余峰	监事	产业投资基金	2019.3.11-2022.3.10
黄奕波	职工监事	职工大会	2019.3.11-2022.3.10

3、高级管理人员  
目前,公司高级管理人员共5人,具体情况如下:

姓名	现任职务	起始时间
李敏忠	总裁	2019.3.11
李伟	执行副总裁、董事会秘书	2019.3.11
梁志龙	执行副总裁、财务负责人	2019.3.11
WANG QINGYU	执行副总裁	2019.3.11
Ku Sakka	执行副总裁	2019.3.11

4、核心技术人员  
公司核心技术人员基本情况如下:

姓名	现任职务
李伟	硅产业集团执行副总裁、董事会秘书、新微科技董事长、上海新昇董事长
WANG QINGYU	硅产业集团执行副总裁、新微科技总经理、董事
Ate Haapilma	Okmetec高级副总裁、首席技术官

5、董事、监事、高级管理人员及核心技术员工持股情况  
本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份,海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限制期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的具体情况请参见本节“七、(一)高级管理人员与核心员工专项资产管理”。

截至本上市公告书签署日,除以上情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份情况。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债务的情况。

发行人存在首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划,根据《激励计划》第四章第三条的规定,若本激励计划的股票期权行权时点为公司上市后,则:(1)激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起3年内不得减持;(2)上述禁售期限届满后,激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

四、员工股权激励情况  
发行人存在首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划(以下简称“本激励计划”),具体情况如下:

1、本激励计划的激励对象  
本激励计划的激励对象共计267人,为发行人及其控股子公司的核心管理人员、核心业务或技术人员,不包括独立董事、监事。

本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条第二款所述的情况,本激励计划的激励对象符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第10.4条的规定。

2、授予股票期权总量  
本公司经批准的股票期权激励计划拟授予激励对象不超过1.296亿股,股票期权、股权激励计划的有效期为5年,自股东大会批准该计划并确定授予之日起计算。公司上市后,不得再依据本计划向激励对象授予股票期权。

本激励计划实际授予激励对象的股票期权数量为不超过公司股本总额的5.87%,但不超过0.50634万股。

据此,发行人全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量占公司上市前总股本的比例未超过15%,且未设置预留权益。

3、未行权数量  
本激励计划为首发申报前制定、上市后实施,均未行权。

4、授予或者登记时间及相关行权  
2019年4月,发行人向员工授予期权,均未行权。

5、限售安排

根据《激励计划》第四章第三条的规定,若本激励计划的股票期权行权时点为公司上市后,则:(1)激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起3年内不得减持;(2)上述禁售期限届满后,激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

五、本次发行前后公司股本情况  
本次发行未采用超额配售选择权,本次发行前后股本结构变动情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
国盛集团	567,000,000	30.48%	567,000,000	22.86%	36个月
产业投资基金	567,000,000	30.48%	567,000,000	22.86%	36个月
武岳峰IC基金	162,000,000	8.71%	162,000,000	6.53%	12个月
新微集团	162,000,000	8.71%	162,000,000	6.53%	12个月
嘉定开发集团	174,272,600	9.37%	174,272,600	7.03%	12个月;其中1,227.26万股股份自2019年3月29日起36个月,且自股票上市之日起12个月
上海新昇	139,653,500	7.51%	139,653,500	5.63%	自2019年3月29日起36个月,且自股票上市之日起12个月
上海中科高科技工业园发展有限公司	4,714,100	0.25%	4,714,100	0.19%	自2019年3月29日起36个月,且自股票上市之日起